



<特徴>

- ・超薄型（シングルパスで30 μm ~2mm）ガラスとサファイアの切断
- ・最高800 mm/秒の高速プロセス
- ・あらゆる形状に対応：円形、正方形、不定形
- ・異なる基板厚に対応可能なダイシングプロセス
- ・内側および外側の輪郭
- ・非強化ガラスの容易なブレーキングと強化ガラスのセルフブレーキング

<ガラスタイプ>

- ・非強化ガラス
- ・強化ガラス
- ・サファイヤ

<加工品質>

- ・切断幅1 μm 以下
- ・チッピング1 μm 以下
- ・後処理不要

FemtoGLASSは、研究開発や大量生産に最適な新しいガラス&サファイア・レーザー切断・ダイシングワークステーションです。特許取得済みのWOPガラス&サファイア切断技術をベースとしており、超高品質で高精度な加工を提供いたします。

Optopia))

日本輸入代理店

オプトピア株式会社

〒213-0012

神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1

かながわサイエンスパーク西棟611

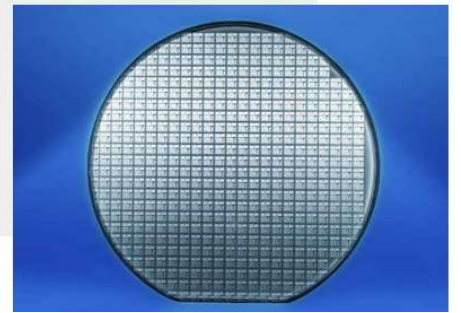
TEL 044-812-5911/ FAX 044-812-5921

sales@optopia.co.jp

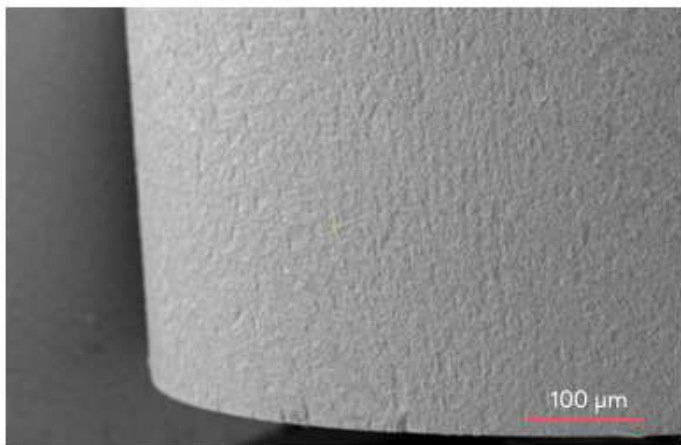
<他方式比較表>

	ブレードダイシング	ステルスレーザー	レーザーアブレーション	WOP FemtoGLASS
加工ガラス厚さ	2から19mm	200 μ mから10mm	30 μ mから2mm	シングルパスで30 μ mから2mm
ガラス種類	全てのタイプ	非強化ガラス、サファイヤ	全てのタイプ	強化ガラス、非強化ガラス、サファイヤ
切断スピード	100mm/秒以上	300mm/秒以上	10mm/秒以上	800mm/秒以上
加工形状	直線切断のみ	T字形、円形状	全ての形状	あらゆる形状に対応
加工表面チッピング	200 μ m以下	50 μ m以下	50 μ m以下	10 μ m以下
切断面粗さ	50 μ m以上	15 μ m以下	50 μ m以上	1 μ m以下
水洗浄	必要	必要なし	必要	必要なし
飛散物	あり	なし	あり	なし
熱影響	あり	なし	あり	なし

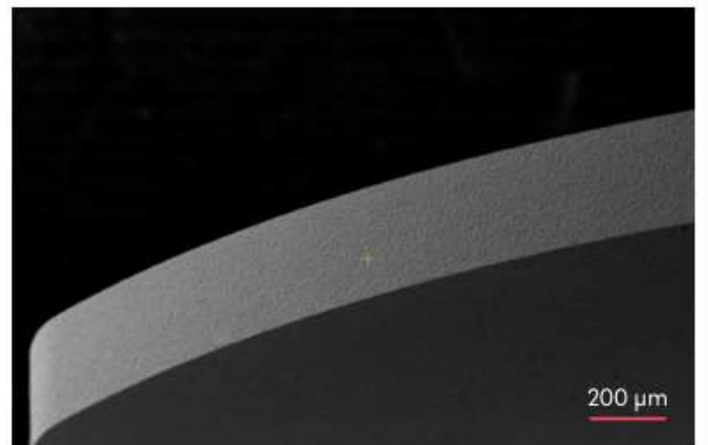
<産業応用>



- 薄板ガラス
- マイクロ光学素子
- 電子部品
- ディスプレイ技術
- コート基板



Sapphire laser cutting, thickness 400 μ m



D236T glass laser cutting, thickness 300 μ m